

Добро пожаловать в О-ведущую

Мы являемся профессиональным производителем печатных плат с более чем десятилетним опытом. Ассортимент продукции - односторонняя, двухсторонняя, многослойная печатная плата, гибкая печатная плата и МСРСВ. Мы можем обеспечить быстрое обслуживание прототипа - S / S за 24 часа, 4-8 слоев за 48-96 рабочих часов.

[\(Многослойная доска производитель Китай\)](#)

Отверстия для медных пластин минимальные .025 AVG, мин .020. Отверстия не могут быть вставлены

Упакуйте бесцветную прозрачную пузырьковую пленку, 25 шт. / Пакет, положите осушитель на бок, положите карточку индикатора влажности на верхнюю сторону

Пожалуйста, нажмите здесь для получения дополнительной информации: [Керамика Flash Gold](#)
[ОПТОМ](#)

описание продукта

PCB P / N	LC057-V1
Количество слоев	1L
материал	Базовая керамика
Совет спасибо	1.6mm
медь спасибо	11oz
Наименьший размер отверстия	/
Количество отверстий (шт.)	/
линия с	15mil
Контроль импеданса. Да / Нет (Tol%)	N
Отделка поверхности	ENIG (Au: 0,05 мкм)
Паяльная маска шелкография	Белый / N / A
Размер одной доски	Dim X (мм): 89; Dim Y (мм): 175
Panelisation	Тусклый X (мм): 89; Тусклый Y (мм): 175; Нет ИБП: 1
Особый	N
Маршрутизация / Штамповка	CNC

•

конкурентоспособны в отрасли на том же уровне качества.
Мы верим в беспроигрышное партнерство с нашими клиентами. Наше партнерство будет взаимовыгодным, если мы сможем предоставить вам преимущество по стоимости и качеству.

3. Какие виды досок могут обрабатывать O-Leading?

Обычные FR4, высокотемпературные и безгалогеновые плиты, Rogers, Arlon, Telfon, плиты на основе алюминия / меди, PI и т. Д.

4. Какие данные необходимы для производства печатных плат?

Лучше всего предоставлять данные в формате Gerber 274-X. Кроме того, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP и Eagle также могут быть обработаны.

5. Каков типичный технологический процесс для многослойной печатной платы?

Резка материала → Внутренняя сухая пленка → Внутреннее травление → Внутренний AOI → Многослойное соединение → Укладка слоев Прессование → Сверление →PTH → Покрытие панели → Наружная сухая пленка → Покрытие рисунка → Внешнее травление → Внешний AOI → Маска припоя → Марка компонента → Поверхностная обработка → Маршрутизация → E / T → Визуальный осмотр.

Наша команда



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Сертификаты

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that
O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED
Credit No: 61691591-000-07-18-7
Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL HK
Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period


First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certification registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the client. The effectiveness of this certificate shall be restricted to those activities which are covered by the certification. The actual information of this certification can be searched on the internet of CICC www.cicc.com.cn. For the sake of clarity see also the logo.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书
证书号: 18118Q10347R05

兹证明
诚领供应链(香港)有限公司
统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7
注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室
经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次监审	第二次监审	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。








ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets UL796	C T	
	Min	Edge			Area Diam mm(in)	Solder Limits C	Oper Temp C			Flame Class
	mm(in)	mm(in)				sec		DSR	I	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.										
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All
Multilayer printed wiring boards.										
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All
Single layer printed wiring boards.										
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Возможность процесса

Возможности производства печатных плат

Количество слоев: 1Layer-32Layer

Толщина готовой меди: 1/3 унции-12 унций

Минимальная ширина линии / расстояние внутри: 3,0 мил / 3,0 мил

Минимальная ширина линии / расстояние между внешними: 4,0 мил / 4,0 мил

Максимальное соотношение сторон: 10: 1

Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм

Максимальный размер панели (дюймов): 635 * 1500 мм

Минимальный размер просверленного отверстия: 4 мил

Допустимое отверстие в отверстиях: +/- 3 мил

Blind / Buried Vias (All Types): ДА

Через заполнение (проводящий, непроводящий): ДА

Материал основания: FR-4, FR-4, высокая Tg. Безгалогеновый материал, Rogers, Алюминиевая основа,полиимида,

Тяжелая медь

Поверхностная обработка: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро с примесьюолово Immersion, золотые пальцы, чернила углерода

Возможности производства SMT

Материал печатной платы: FR-4, СЕМ-1, СЕМ-3, алюминиевая плата

Максимальный размер печатной платы: 510x460 мм

Минимальный размер печатной платы: 50x50 мм

Толщина печатной платы: 0.5mm-4.5mm

Толщина доски: 0,5-4 мм

Минимальный размер компонентов: 0201

Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше

Максимальная высота компонента: 15 мм

Минимальный шаг подачи: 0,3 мм

Мин BGA шаг шага: 0,4 мм

Точность размещения: +/- 0,03 мм